

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2024022

浙江东晶电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2024年5月20日召开2023年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司向东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）提供不超过15,000万元人民币的担保额度。具体内容详见公司分别于2024年4月18日、2024年5月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024009）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024021）。

二、担保进展情况

近日，公司签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：571XY202401642101），为全资子公司东晶金华向招商银行股份有限公司金华分行（以下简称“招行金华分行”）申请人民币2,500万元的授信额度提供连带责任保证担保。公司原于2023年与招行金华分行签订的最高额3,000万元的《最高额不可撤销担保书》（编号：571XY202302669101）同时终止。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	经审批可用担保总额度	截至目前担保余额	本次新增担保余额	对子公司担保余额占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
东晶电子	东晶金华	100.00%	34.57%	15,000.00	2,500.00	2,500.00	8.29%	否

上述担保金额在公司董事会、股东大会审议批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：东晶电子金华有限公司

2、注册资本：人民币 10,000 万元

3、成立日期：2015 年 09 月 15 日

4、法定代表人：石佳霖

5、住所：浙江省金华市婺城区宾虹西路 555 号 5 幢厂房

6、经营范围：电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、计算机网络设备、通信产品、机械设备、仪器仪表、高压直流继电器、印制电路板、传感器、蓝宝石窗口片、蓝宝石衬底片、外延片、芯片的研发、设计、生产与销售，企业管理咨询（不含金融、证券、期货业务咨询），实业投资，资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目），道路货物运输（凭有效许可证件经营）。

7、股权结构：截至本公告披露日，东晶金华为公司直接持股 100%的全资子公司。

8、东晶金华最近一年又一期的财务状况如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	5,762.12	21,742.04
利润总额	-241.04	-5,658.57
净利润	-241.04	-5,658.57
项目	2024/3/31（未经审计）	2023/12/31（经审计）
资产总额	61,831.31	60,438.21
负债总额	22,528.87	20,894.73
其中：银行贷款总额	11,290.68	11,492.58
流动负债总额	15,557.52	13,598.06
或有事项		
其中：担保	-	-
抵押	4,634.45	4,746.77
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	39,302.44	39,543.48

9、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，东晶金华不是失信被执行人。

四、担保书主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司金华分行；

2、债务人：东晶电子金华有限公司；

3、保证人：浙江东晶电子股份有限公司；

4、最高债权额：人民币 2,500 万元整；

5、担保范围：债权人向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额人民币 2,500 万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

6、保证方式：连带责任保证；

7、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计担保数额及逾期担保情况

本次担保后，公司及控股子公司已发生的担保余额为 2,500.00 万元，均为公司对全资子公司东晶金华提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.29%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》；

2、《授信协议》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十五日